

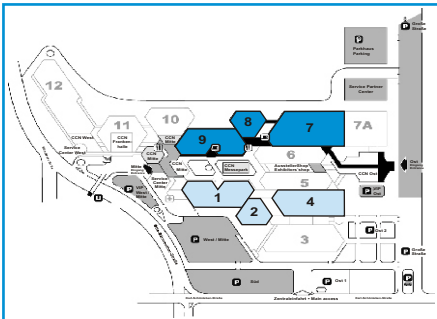
Messe-Ankündigung SMT / HYBRID / PACKAGING

Die SMT / HYBRID / PACKAGING ist Europas führende Fachmesse für Systemintegration in der Mikroelektronik und wird von einem internationalen Kongress mit Tutorials begleitet.

Sie ist seit 18 Jahren fest in Europa etabliert und internationaler Treffpunkt für ein entscheidungskompetentes Fachpublikum. Die Messe findet - wie üblich - im Messezentrum Nürnberg statt:

19. bis 21. April 2005

Die Aussteller präsentieren Design und Entwicklung über Leiterplattenfertigung, Bauelemente, Aufbau- und Bestückungstechnologien bis hin zum Test-Equipment- alles kompakt und übersichtlich unter einem Dach. Die Geländeübersicht zeigt die neue Nutzung der Messehallen 7 - 8 - 9 für 2005 im Gegensatz zum Vorjahr, wo die Messe in den Hallen 1 - 2 - 4 stattfand.



Wie auch in den Vorjahren ist **ANDUS ELECTRONIC** Aussteller dieser Messe in Nürnberg. Unser Messe-Team, Fachingenieure der Leiterplattentechnik, informiert und betreut Sie auf unserem Stand.

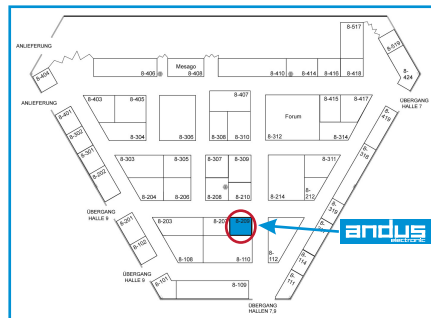
Seit nunmehr **35 Jahren** produziert ANDUS Leiterplatten-Prototypen in allen high-tech-orientierten Technologien. Unser Technologietransfer führt uns weit durch alle Industriebereiche zu unseren Kunden; wir

- verhandeln
- diskutieren

- informieren
- beraten
- vermitteln
- und vieles mehr

zu Leiterplatten-Projekten im Hause unserer Geschäftspartner, in Schulungsräumen unseres Berliner Betriebes, zu Seminaren und Tagungen in den Industriebereichen aller Bundesländer und selbstverständlich auch auf unseren Messeständen der wichtigsten Fachausstellungen.

Wir laden Sie zu einem Besuch der Mikroelektronik-Messe SMT / HYBRID / PACKAGING auf unseren Messe-Stand ein; **in Halle 8 - Stand-Nr. 8-209**



Einladungskarten für den freien Eintritt zur Messe erhalten Sie noch rechtzeitig von uns vor Messebeginn.

Wir zeigen Ihnen Leiterplatten für zukunftsorientierte Elektronik:

- Bilayer mit Mikroleiterbahnen
- Hochlagige Multilayer für THT und SMD
- HF- und Impedanzschaltungen
- Flexible / Starrflexible-Leiterbahnen
- Pluggen / Via-in-Pad
- Blei- und Halogenfrei
- Thermal-Management

Wir erwarten Sie zu interessanten Fachgesprächen und freuen uns auf Ihren Besuch.

Haus-Information

Neue Persönlichkeit:

Unsere Leiterplattenprodukte und Technologien, in Verbindung mit der Spezialisierung zu Prototypen im **ANDUS-Terminsystem**, sind äußerst beratungsintensiv und erfordern dafür immer wieder einen Fachmann für Vertrieb und Technik. Für diese Aufgaben konnten wir einen neuen Mitarbeiter gewinnen, der bereits seit dem 01.10.2004 in unserem Hause tätig ist. Nach Abschluss der Einarbeitung ist er nun Ihr neuer Kontaktpartner:



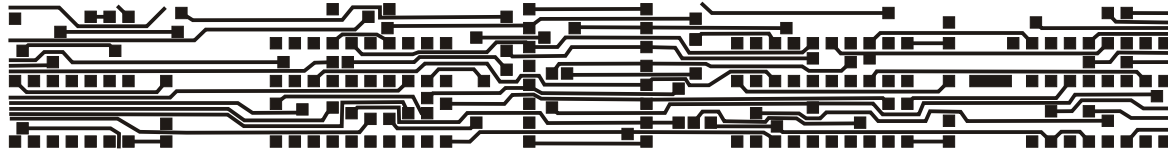
Herr Axel Fetting

Erfahrungen aus 2 Jahrzehnten Leiterplattentechnik von der Entflechtung über die Prototypenfertigung bis zur Serienfertigung und Bestückung sind die besten Grundlagen für die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern.

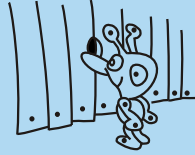
Herr Fetting ist vorrangig für die Betreuung unserer Kunden im Raum Berlin, Brandenburg und Sachsen zuständig und darüber hinaus als stellvertretender Vertriebsleiter auch überregional zu allen Fragen Ihr kompetenter Ansprechpartner. Sie erreichen ihn:

Tel. 030-61 00 06-47
Handy 0178-611 00 71
E-Mail a.fetting@andus.de

Herr Fetting möchte sich um Sie kümmern; bitte fordern Sie ihn!



Blick in die Technik:



Fenstertechnik für Starrflex-Leiterplatten

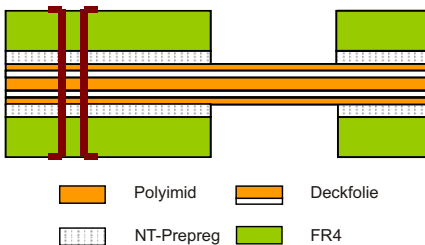
Der Einsatz von Starrflex-Leiterplatten erobert zunehmend die Elektronik aller Industriebereiche. Die kompakte Einheit von mehrlagigen Starnteilen und deren Verbindung mit flexiblen Schaltungsteilen bringt vereinfachtes Handling, bequemen Ein- und Ausbau bei Montage sowie Reparaturen und vor allem höhere Sicherheit im Schaltungssystem.

Der Schaltungsaufbau nach der sogenannten "Fenstertechnik" kann für individuelle Einsatzbereiche zusätzliche Sicherheit bieten.

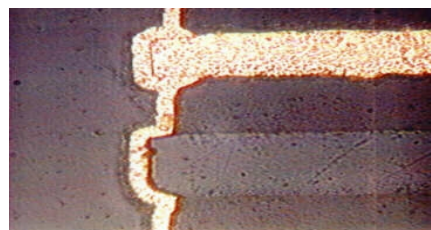
Die **Fenstertechnik** bezeichnet die Aufbauvarianten bei Starrflex-Leiterplatten, bei denen die (kleberhaltige) Deckfolie nicht den gesamten Starrbereich bedeckt, sondern vom Flexbereich nur wenige Millimeter unter den Starrflex-Übergangsbereich hineinläuft.

Die **Fenstertechnik** vereint die Vorteile der herkömmlichen Starrflex-Technologie mit Kleberschichten und die der kleberlosen Aufbauten.

Herkömmlicher Starrflex-Aufbau:



Legend for traditional construction:
Orange: Polyimid, White: NT-Prepreg, Green: FR4, Yellow: Deckfolie

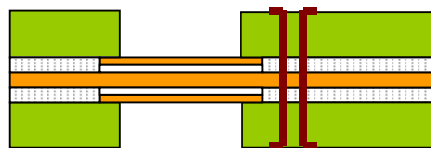


Hülseauschnitt mit rückgeätzten Kleberschichten

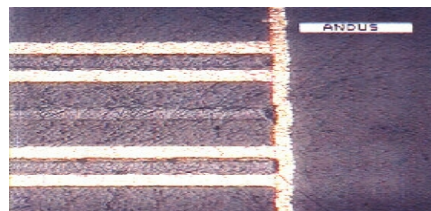
Vorteil der herkömmlichen Starrflex-Technologie:

- Polyimid-Deckfolie ist mechanisch belastbarer als Bondply-Deckschicht (Elastizität + Reißfestigkeit)
- Haffester Verbund zwischen Flex-Lagen und Deckfolie

Aufbau der Fenstertechnik:



Legend for window technology construction:
Orange: Polyimid, White: NT-Prepreg, Green: FR4, Yellow: Deckfolie



Kleberlose Hülsen mit Polyimid-Schicht

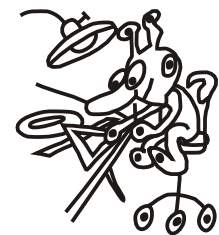
Vorteile der Fenstertechnik bei Starrflex-Leiterplatten:

- Keine Kleberschichten in Bereich der Durchkontaktierung
- Saubere Bohrungen - (glattere Hülsen)
- Thermomechanische Zuverlässigkeit deutlich höher (kaum Hülsendehnung)

Zu weiteren Informationen, technischen Beratungen sowie auch zu direkten Projektbesprechungen, steht Ihnen jederzeit unser

Herr Lothar Oberender
Tel. 030-61 00 06-20
E-Mail l.oberender@andus.de

gerne zur Verfügung.



Übrigens...

...Die "Leiterplatte des Monats" mit jeweils einer Technologiebeschreibung finden Sie regelmäßig im Internet auf unserer Homepage unter

www.andus.de;

schauen Sie einfach mal wieder rein.

...hier nochmals ein wichtiger Hinweis an unsere "neuen Partner", die häufig durch **INFORMANDUS**-Empfehlungen zu uns gelangen:

Bitte geben Sie uns bei E-Mail-Anfragen immer noch zusätzlich ihre Firmendaten und Telefon-Nummer an, damit evtl. Notwendige Rückfragen zügig geklärt werden können - danke!

